



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23293X

Issue Date: 01 Jun 2020

Title of Change:	SOIC8 Cu wire qualification at HANA including BOM change.	
Proposed First Ship date:	29 Nov 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Scott.Brow@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Product marked with date code 2044 may be built with the changes listed in this IPCN. This date should be reviewed again at the release of the FPCN.	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
None	HANA Semiconductor, Thailand	
Description and Purpose:		
ON Semiconductor would like to notify customers of our plan to qualify Cu wire with the following BOM Changes for our SOIC-8 products running in our Subcon, HANA Thailand.		
There will be no change in the package outline associated with these BOM changes:		
	Before Change Description	After Change Description
Lead Frame plating	PPF (AuAg)	CuAg with Sn100%
Die Attach	QMI519	EN4900LC18
Bond Wire	Au wire	CuPd wire
Mold Compound	CEL8240HF10LYR and GR828FC1	CV8214C

**Qualification Plan:**QV DEVICE NAME: FAN7380MXRMS# : O62530, K64158PACKAGE : SOIC 8L

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTRB	JESD22-A108	Ta=125°C, 80% max rated V	2016 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= 65°C to +150°C	1000 cyc
THB	JESD22-A101C	85°C, 85% RH, bias	2016 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL1@ 260°C	
SAT	JEDEC STD 035	Pre and Post MSL 1	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	
PD	JESD22-B100	Per POD, case 751EG	
CDPA	MILSTD750, Method 2037	Custom Destructive Physical Analysis - Wire Pull after TC500 cycles	
CDPA	AEC -006	Custom Destructive Physical Analysis – Ball Shear after TC500	
DPA	AEC Q101 -004	Destructive Physical Analysis after TC, THB, HTRB	

QV DEVICE NAME: FAN3121CMXRMS# : 64968PACKAGE : SOIC 8L

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= 65°C to +150°C	1000 cyc
THB	JESD22-A101C	85°C, 85% RH, bias	2016 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL1@ 260°C	
SAT	JEDEC STD 035	Pre and Post MSL 1	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	
PD	JESD22-B100	Per POD, case 751EB	
CDPA	MILSTD750 Method 2037	Wire Pull after TC500 cycles	
DPA	AEC Q101 -004	Destructive Physical Analysis after TC, THB	

Estimated date for qualification completion: 31 July 2020

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
FAN73611MX	FAN7380MX
FAN73611MX-OP	FAN7380MX
FAN73711MX	FAN7380MX
FAN7380MX-OP	FAN7380MX
FAN7602BMX	FAN7380MX
SC73611MX	FAN7380MX
FAN7380MX	FAN7380MX
FAN3121CMX	FAN3121CMX
FAN3121TMX	FAN3121CMX
FAN3122CMX	FAN3121CMX
FAN3122TMX	FAN3121CMX
FAN3213TMX	FAN3121CMX
FAN3214TMX	FAN3121CMX
FAN3216TMX	FAN3121CMX
FAN3217TMX	FAN3121CMX
FAN3223CMX	FAN3121CMX
FAN3223TMX	FAN3121CMX
FAN3224CMX	FAN3121CMX
FAN3224TMX	FAN3121CMX
FAN3225TMX	FAN3121CMX
FAN3226CMX	FAN3121CMX
FAN3226TMX	FAN3121CMX
FAN3227CMX	FAN3121CMX
FAN3227TMX	FAN3121CMX
FAN3229CMX	FAN3121CMX
FAN3229TMX	FAN3121CMX
FAN3268TMX	FAN3121CMX
FAN3225CMX	FAN3121CMX

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23293X

発行日: 01 Jun 2020

変更件名:	BOM 変更も含む HANA における SOIC8 銅ワイヤの認定	
初回出荷予定日:	29 Nov 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Scott.Brow@onsemi.com にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら PCN.Support@onsemi.com にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレサビリティ:	日付コード 2044 がマークされた製品は、本 IPCN にリストされた変更に従い製造される場合があります。この日付は、本 FPCN の配信時に再度確認する必要があります。	
変更カテゴリ:	Assembly Change	
変更サブカテゴリ:	Material Change	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
なし	HANA Semiconductor, Thailand	
説明および目的:	<p>オン・セミコンダクターは、外注工場である HANA (タイ) で製造している SOIC-8 製品において、銅ワイヤと以下の BOM 変更を認定する計画について、お客様に通知させていただきます。</p> <p>本 BOM 変更に伴うパッケージ外形の変更はありません。</p>	
	変更前の表記	変更後の表記
リード仕上げ	PPF (AuAg)	CuAg with Sn100%
ダイ接着剤	QMI519	EN4900LC18
ボンドワイヤ	Au wire	CuPd wire
モールド・コンパウンド	CEL8240HF10LYR and GR828FC1	CV8214C



認定計画:

デバイス名: FAN7380MXRMS : O62530, K64158パッケージ: SOIC 8L

テスト	規格	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTRB	JESD22-A108	Ta=125°C, 80% max rated V	2016 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= 65°C to +150°C	1000 cyc
THB	JESD22-A101C	85°C, 85% RH, bias	2016 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL1@ 260°C	
SAT	JEDEC STD 035	Pre and Post MSL 1	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	
PD	JESD22-B100	Per POD, case 751EB	
CDPA	MILSTD750, Method 2037	Custom Destructive Physical Analysis - Wire Pull after TC500 cycles	
CDPA	AEC -006	Custom Destructive Physical Analysis – Ball Shear after TC500	
DPA	AEC Q101 -004	Destructive Physical Analysis after TC, THB, HTRB	

デバイス名: FAN3121CMXRMS : 64968パッケージ: SOIC 8L

テスト	規格	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= 65°C to +150°C	1000 cyc
THB	JESD22-A101C	85°C, 85% RH, bias	2016 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL1@ 260°C	
SAT	JEDEC STD 035	Pre and Post MSL 1	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	
PD	JESD22-B100	Per POD, case 751EB	
CDPA	MILSTD750 Method 2037	Wire Pull after TC500 cycles	
DPA	AEC Q101 -004	Destructive Physical Analysis after TC, THB	

認定完了予定日: 31 July 2020



影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FAN73611MX	FAN7380MX
FAN73611MX-OP	FAN7380MX
FAN73711MX	FAN7380MX
FAN7380MX-OP	FAN7380MX
FAN7602BMX	FAN7380MX
SC73611MX	FAN7380MX
FAN7380MX	FAN7380MX
FAN3121CMX	FAN3121CMX
FAN3121TMX	FAN3121CMX
FAN3122CMX	FAN3121CMX
FAN3122TMX	FAN3121CMX
FAN3213TMX	FAN3121CMX
FAN3214TMX	FAN3121CMX
FAN3216TMX	FAN3121CMX
FAN3217TMX	FAN3121CMX
FAN3223CMX	FAN3121CMX
FAN3223TMX	FAN3121CMX
FAN3224CMX	FAN3121CMX
FAN3224TMX	FAN3121CMX
FAN3225TMX	FAN3121CMX
FAN3226CMX	FAN3121CMX
FAN3226TMX	FAN3121CMX
FAN3227CMX	FAN3121CMX
FAN3227TMX	FAN3121CMX
FAN3229CMX	FAN3121CMX
FAN3229TMX	FAN3121CMX
FAN3268TMX	FAN3121CMX
FAN3225CMX	FAN3121CMX



Appendix A: Changed Products

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle	New Part Number	Replacement Supplier
FAN73611MX		FAN7380MX		
FAN73711MX		FAN7380MX		
FAN7380MX-OP		FAN7380MX		
FAN7602BMX		FAN7380MX		
FAN7380MX		FAN7380MX		
FAN3121CMX		FAN3121CMX		
FAN3121TMX		FAN3121CMX		
FAN3122CMX		FAN3121CMX		
FAN3122TMX		FAN3121CMX		
FAN3213TMX		FAN3121CMX		
FAN3214TMX		FAN3121CMX		
FAN3216TMX		FAN3121CMX		
FAN3217TMX		FAN3121CMX		
FAN3223CMX		FAN3121CMX		
FAN3223TMX		FAN3121CMX		
FAN3224CMX		FAN3121CMX		
FAN3224TMX		FAN3121CMX		
FAN3225TMX		FAN3121CMX		
FAN3226CMX		FAN3121CMX		
FAN3226TMX		FAN3121CMX		
FAN3227CMX		FAN3121CMX		
FAN3227TMX		FAN3121CMX		
FAN3229CMX		FAN3121CMX		
FAN3229TMX		FAN3121CMX		
FAN3268TMX		FAN3121CMX		
FAN3225CMX		FAN3121CMX		
FAN73611MX-OP		FAN7380MX		